NORME INTERNATIONALE

INTERNATIONAL STANDARD

CEI
IEC
60191-2

AMENDEMENT 5
AMENDMENT 5
2002-02

Amendement 5

Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs –

Partie 2: Dimensions

Amendment 5

Mechanical standardization of semiconductor devices –

Part 2: Dimensions

Les feuilles de cet amendement sont à insérer dans la Publication 60191-2

The sheets contained in this amendment are to be inserted in Publication 60191-2

CODE PRIX
PRICE CODE F

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

INSTRUCTIONS POUR L'INSERTION DES NOUVELLES PAGES DANS LA CEI 60191-2

Remplacer la page de titre existante par la nouvelle page de titre.

Retirer la page 60191 IEC I existante contenant la préface et la remplacer par la nouvelle page 60191 IEC I contenant la préface à l'amendment 5 (2002).

Chapitre I:

Ajouter les nouvelles feuilles suivantes:

60191 IEC I-165E - a/b/c/d/e/f

INSTRUCTIONS FOR THE INSERTION OF NEW PAGES IN IEC 60191-2

Replace the existing title page with the new title page.

Remove the existing page 60191 IEC I containing the preface and insert in its place the new page 60191 IEC I containing the preface to Amendment 5 (2002).

Chapter I:

Add the following new sheets:

60191 IEC I-165E - a/b/c/d/e/f

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

NORME INTERNATIONALE

INTERNATIONAL STANDARD

CEI
IEC
60191-2

Première édition
First edition
1966

Modifiée selon les Compléments:
Amended in accordance with Supplement:
A (1967), B (1969), C (1970), D (1971), E (1974), F (1976), G (1978), H (1978), J (1980), K (1981), L (1982), M (1983), N (1987), P (1988), Q (1990), R (1995), S (1995), T(1995), U(1997), V(1998), W(1999), X(1999), Y(2000), Z(2000) et/and Amendement/Amendment 1 (2001), 2(2001), 3(2001), 4(2001), 5(2002)

Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs –

Partie 2: Dimensions

Mechanical standardization of semiconductor devices –

Part 2: Dimensions

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

© IEC 2002 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch

Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PUBLICATION 191-2

NORMALISATION MÉCANIQUE DES DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS

DEUXIÈME PARTIE: DIMENSIONS

SOMMAIRE

PRÉAMBULE

PRÉFACE

CONCEPTION DE LA NORMALISATION MÉCANIQUE ..... Chapitre 00

VALEURS RECOMMANDÉES POUR CERTAINES DIMENSIONS DE DESSINS DE DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS..... Chapitre 0

DESSINS D'ENCOMBREMENTS..... Chapitre I

TYPES DE DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS GÉNÉRALEMENT MONTÉS DANS LES BOÎTIERS DU CHAPITRE I

DESSINS D'EMBASES..... Chapitre II

DESSINS DE BOÎTIERS ..... Chapitre III

DESSINS DE CALIBRES ..... Chapitre IV

TABLEAUX MONTRANT LES ASSOCIATIONS ENTRE LES BOÎTIERS ET LES EMBASES ..... Chapitre V

DESSINS OBSOLÈTES

COMPLÉMENTS AUX LISTES DE CODES NATIONAUX FIGURANT SUR LES FEUILLES DES NORMES DE LA PUBLICATION 191-2 DE LA CEI

SUPPRESSIONS DANS LES LISTES DE CODES NATIONAUX FIGURANT SUR LES FEUILLES DE NORMES DE LA PUBLICATION 191-2 DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PUBLICATION 191-2

MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES

PART 2: DIMENSIONS

CONTENTS

FOREWORD

PREFACE

PHILOSOPHY OF MECHANICAL STANDARDIZATION ..... Chapter 00

RECOMMENDED VALUES FOR CERTAIN DIMENSIONS OF DRAWINGS OF SEMICONDUCTOR DEVICES ..... Chapter 0

DEVICE OUTLINE DRAWINGS ..... Chapter I

TYPES OF SEMICONDUCTOR DEVICES GENERALLY MOUNTED IN THE PACKAGES OF CHAPTER I

BASE DRAWINGS..... Chapter II

CASE OUTLINE DRAWINGS..... Chapter III

GAUGE DRAWINGS ..... Chapter IV

TABLES SHOWING ASSOCIATIONS BETWEEN CASE OUTLINES AND BASES..... Chapter V

OBSOLETE DRAWINGS

ADDITIONS TO THE LISTS OF NATIONAL CODES APPEARING ON THE STANDARD SHEETS OF IEC PUBLICATION 191-2

DELETIONS TO THE LISTS OF NATIONAL CODES APPEARING ON THE STANDARD SHEETS OF IEC PUBLICATION 191-2

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

_____

Amendement 5 (2002) à la CEI 60191-2 (1966)

NORMALISATION MÉCANIQUE DES DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS –

Partie 2: Dimensions

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

PRÉFACE À L'AMENDEMENT 5 (2002)

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 47D: Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs du comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
47D/466/FDIS	47D/475/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Amendment 5 (2002) to IEC 60191-2 (1966)

MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES –

Part 2: Dimensions

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

PREFACE TO AMENDMENT 5 (2002)

This amendment has been prepared by subcommittee 47D: Mechanical standardization of semiconductor devices of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
47D/466/FDIS	47D/475/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

CHAPITRE 00 – CONCEPTION DE LA NORMALISATION MÉCANIQUE

1. Règles fondamentales

Lors de la réunion tenue à Montreux (juin 1981), le Comité d'Etudes n° 47 adopta les règles fondamentales suivantes qui remplacent celles adoptées à Copenhague en octobre 1962:

A. Toute proposition nouvelle devra être soumise à l'étude préliminaire d'un groupe de travail convenablement qualifié (note 1) avant circulation dans un document Secrétariat.

B. Le groupe de travail qualifié devra étudier les nouvelles propositions avec les objectifs suivants:

1. Aboutir à une normalisation active en n'acceptant que les boîtiers qui sont soutenus internationalement.
2. Spécifier de façon précise les dimensions en vue d'assurer l'interchangeabilité et de faciliter les manipulations automatiques.
3. Reconsidérer continuellement les dessins existants et proposer la suppression de ceux qui ne sont plus soutenus.

C. Il ne sera procédé à la discussion d'un dessin de boîtier que s'il a le soutien préalable d'au moins trois pays.

D. Un dessin ne sera introduit dans la Publication 191-2 de la CEI que si au moins trois des pays qui le soutiennent ont fourni leur numéro de code national (ou exprimé un soutien formel s'ils ne possèdent pas de numéro de code).

Notes 1. – Lors de la réunion du Comité d'Etudes n° 47 à Orlando (février 1980), il a été admis d'étendre le domaine d'activité du GT7 de façon qu'il couvre aussi bien la normalisation mécanique des semiconducteurs discrets que celle des circuits intégrés.

Il a été également admis que, compte tenu de l'élargissement de son domaine d'activité, le GT7 serait le groupe de travail qualifié mentionné dans le paragraphe A.

En vue d'éviter que l'introduction du GT7 dans le processus suivi par le Comité d'Etudes n° 47 pour préparer des documents secrétariat sur la normalisation mécanique provoque des délais supplémentaires, le GT7 a été autorisé à obtenir de la part des trois pays concernés, ou plus, la confirmation directe du maintien de leur appui pour ces propositions.

2. – Lors de la réunion du Comité d'Etudes n° 47 à Montreux (juin 1981), il a été admis que les réunions du GT7 s'intégreraient dans les réunions du Comité d'Etudes n° 47.

Cependant, certaine propositions peuvent nécessiter un temps d'études dépassant la durée d'une réunion du Comité d'Etudes n° 47 et en conséquence requérir une ou plusieurs réunions du GT7 entre deux réunions consécutives du Comité d'Etudes n° 47.

Lors de la réunion tenue à Moscou (juin 1977), le Comité d'Etudes n° 47 adopta la règle suivante:

Lorsqu'un dessin de la Publication 191-2 de la CEI vient à ne plus être soutenu que par un seul pays, il sera retiré de la publication principale et transféré dans une section séparée intitulée «Dessins obsolètes» avec l'indication de la date de transfert sur la feuille particulière correspondante.

Un avertissement au début de la section dévolue aux dessins obsolètes stipulera qu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa date de transfert, le dessin sera supprimé, sauf s'il est soutenu par un autre pays dans l'intervalle.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

CHAPITRE I – DESSINS D'ENCOMBREMENTS

Liste des dessins *(suite)*

Numéro de code CEI	Code du pays d'origine	Numéro de page et date	
116E01	SC-529-14BA	I-116E	1988
116E02	SC-530-16CA		
116E03	SC-531-20AA		
117E01	SC-530-16BA	I-117E	1988
117E02	SC-531-20BA		
117E03	SC-532-24AA		
117E04	SC-533-28AA		
117E05	SC-533-28BA		
118E01	SC-532-24BA	I-118E	1988
118E02	SC-533-28CA		
119E02	(Etats-Unis)	I-119E	1990
119E03			
120E	NT194	I-120E	1990
121E	NT213	I-121E	1994
122E	NT221	I-122E	1994
123E		I-123E	1997
129E	NT223	I-129E	1994
133E		I-133E	2000
134E		I-134E	2000
135E		I-135E	2000
136E		I-136E	2000
137E		I-137E	2000
138E		I-138E	
139E		I-139E	
140E		I-140E	1999
141E		I-141E	1999
142E		I-142E	1998
143E		I-143E	1998
7144E		I-144E	1999
147E		I-147E	1999
148E		I-148E	1999
149E		I-149E	2000
154E		I-154E	2001
155E		I-155E	2001
159E		I-159E	2001
160E		I-160E	2001
161E		I-161E	2001
162E		I-162E	2001
164E		I-164E	2001
165E		I-165E	2002
Forme F			
084F		I-084F	1996
100F		I-100F	1990
101F01	101F01	I-101F	1998
101F01	101F01		
102F		I-102F	1998
102F0	102F01		
102F02	102F02		
102F033	102F03		

CHAPTER I – DEVICE OUTLINE DRAWINGS

List of drawings *(continued)*

IEC code number	Code of country of origin	Page number and date	
116E01	SC-529-14BA	I-116E	1988
116E02	SC-530-16CA		
116E03	SC-531-20AA		
117E01	SC-530-16BA	I-117E	1988
117E02	SC-531-20BA		
117E03	SC-532-24AA		
117E04	SC-533-28AA		
117E05	SC-533-28BA		
118E01	SC-532-24BA	I-118E	1988
118E02	SC-533-28CA		
119E02	(USA)	I-119E	1990
119E03			
120E	NT194	I-120E	1990
121E	NT213	I-121E	1994
122E	NT221	I-122E	1994
123E		I-123E	1997
129E	NT223	I-129E	1994
133E		I-133E	2000
134E		I-134E	2000
135E		I-135E	2000
136E		I-136E	2000
137E		I-137E	2000
138E		I-138E	
139E		I-139E	
140E		I-140E	1999
141E		I-141E	1999
142E		I-142E	1998
143E		I-143E	1998
144E		I-144E	1999
147E		I-147E	1999
148E		I-148E	1999
149E		I-149E	2000
154E		I-154E	2001
155E		I-155E	2001
159E		I-159E	2001
160E		I-160E	2001
161E		I-161E	2001
162E		I-162E	2001
164E		I-164E	2001
165E		I-165E	2002
Form F			
084F		I-084F	1996
100F		I-100F	1990
101F01	101F01	I-101F	1998
101F01	101F01		
102F		I-102F	1998
102F0	102F01		
102F02	102F02		
102F033	102F03		

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

CHAPITRE I – DESSINS D'ENCOMBREMENTS

Liste des dessins *(suite)*

Numéro de code CEI	Code du pays d'origine	Numéro de page et date	
Forme G			
050G01	SO5-87D		
050G02	SO-188D		
050G03	SO-87A		
050G04	SO-87B		
050G05	SO-188A		
050G06	SO-188B		
050G07	SO-188F	I-50a/b/c/d	1985
050G08	SO-87C		
050G10	SO-188C		
050G11	SO505-18A		
050G12	SO-87G		
050G13	SO-188E		
050G14	(Suède)		
050G16	A1AA		
050G17	A1AB		
050G18	A1BA	I-50e	1990
050G19	A1BB		
050G20	A1CB		

CHAPTER I – DEVICE OUTLINE DRAWINGS

List of drawings *(continued)*

IEC code number	Code of country of origin	Page number and date	
Form G			
050G01	SO5-87D		
050G02	SO-188D		
050G03	SO-87A		
050G04	SO-87B		
050G05	SO-188A		
050G06	SO-188B		
050G07	SO-188F	I-50a/b/c/d	1985
050G08	SO-87C		
050G10	SO-188C		
050G11	SO505-18A		
050G12	SO-87G		
050G13	SO-188E		
050G14	(Sweden)		
050G16	A1AA		
050G17	A1AB		
050G18	A1BA	I-50e	1990
050G19	A1BB		
050G20	A1CB		

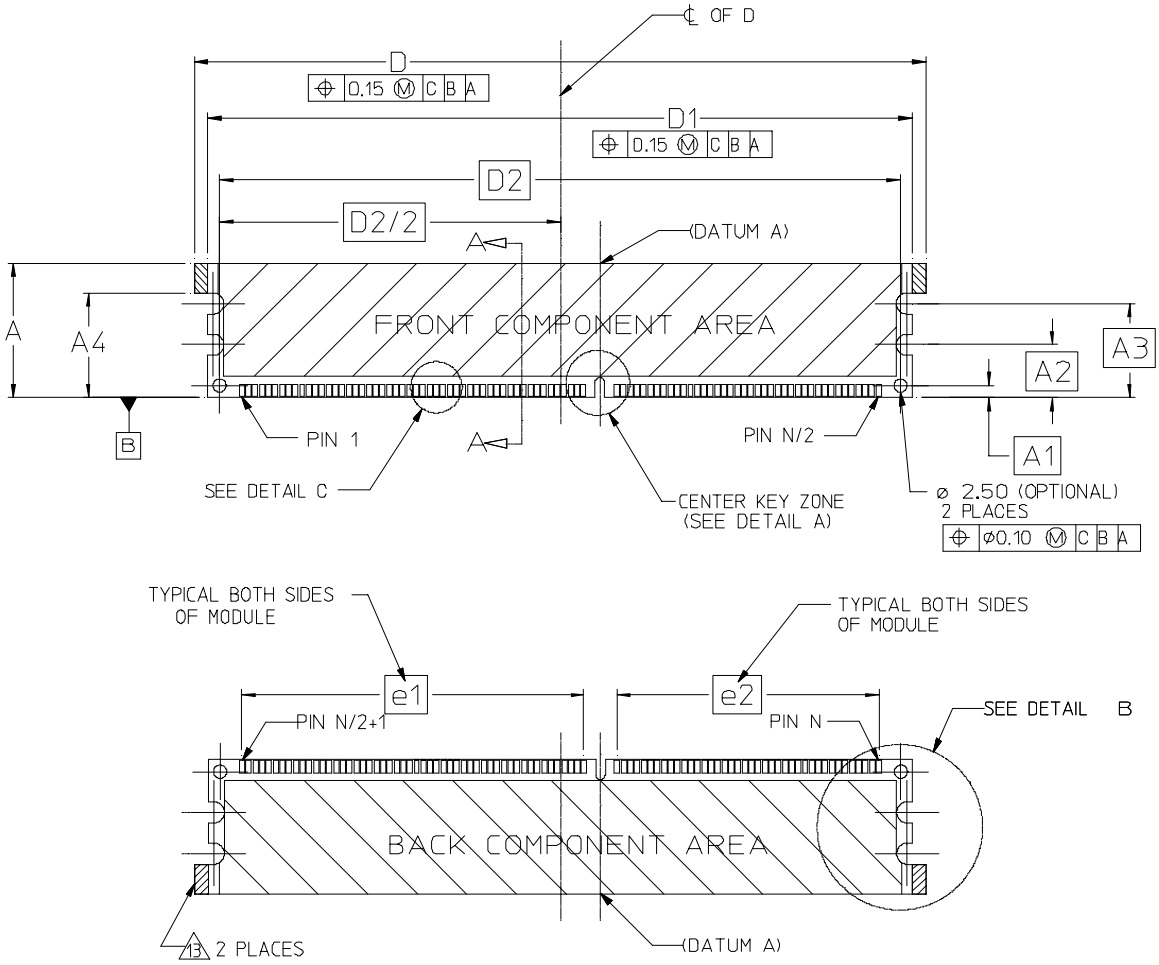
LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

Types de dispositifs à semiconducteurs généralement montés dans les boîtiers du chapitre I de la CEI 60191-2

Types of semiconductor devices generally mounted in the packages of chapter I of IEC 60191-2

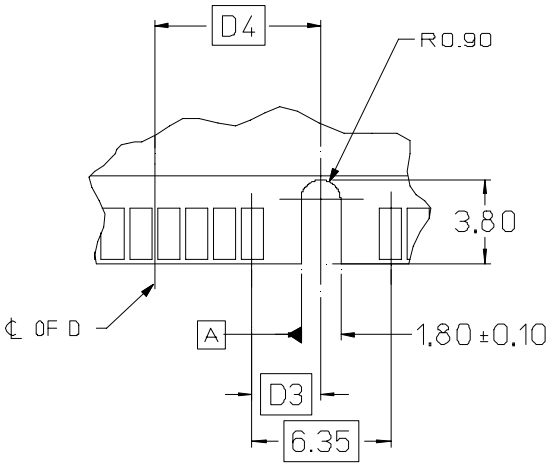
Type de dispositif Type of device	Numéro de code CEI du dessin du boîtier IEC code number of package drawing
Diodes de signal et diodes Zener de faible puissance Signal diodes and small-power Zener diodes	A1, A20, A24, A32, A54, A55, A58, A67, A69, A70, A71, 098H, 100H
Diodes hyperfréquences Microwave diodes	A18
Diodes de redressement de faible et moyenne puissance Rectifier diodes, small and medium power	A2, A3, A4, A6, A7, A19, A37, A44, A74, 077B, 100B
Diodes de redressement de forte puissance High-power rectifier diodes	A8, A9, A10, A15, A16, A17, A21, A22, A35, 083B, 103B
Thyristors de faible et moyenne puissance Thyristors, small and medium power	A11, A13, A14, A38, A43
Thyristors de forte puissance High-power thyristors	A12, A27, A28, A29, A34, A39, A47, 104B, 105B
Transistors de signal Signal transistors	A36, A40, A41, 068A, 046E, 114E
Transistors de puissance Power transistors	A23, A30, A31, A43, A48, A56, A57, A45, A73, 080B, 081B, 082B, 101B, 102B, 102F, 120E, 084F, P100F
Transistors hyperfréquences Microwave transistors	A26, A42, A43, A59, A66, A72, 100C
Dispositifs optoélectroniques Optoelectronic devices	A62, A64, A65, A63A, 100A, 101A, 106B, 107B
Circuits intégrés Integrated circuits	A52, A53, A61, 075E, 076E, 099E, 100E, 102E, 112E, 115E, 116E, 117E, 118E, 119E, 121E, 122E, 123E, 129E, 133E, 134E, 135E, 136E, 137E, 138E, 139E, 140E, 141E, 144E, 147E, 148E, 149E, 154E, 155E, 159E, 160E, 161E, 162E, 164E, 165E, 050G, 051G, 060G, 100G, 101G

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.



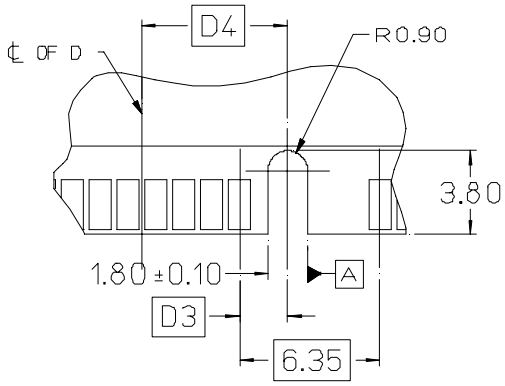
	Dual in line memory module (DIMM) family 184 pin DDR 1,27 mm contact centres	Date: 2002
	60191 IEC I-165E-a	

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

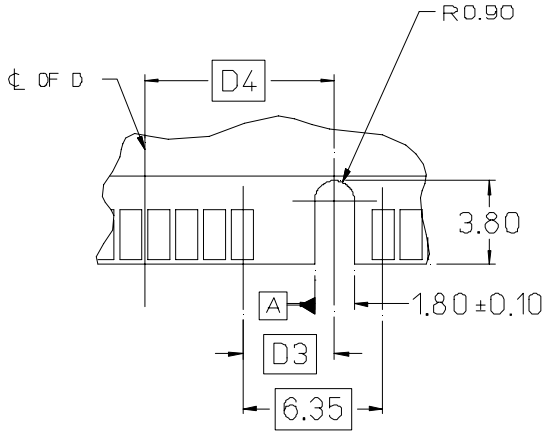


SCALE 4:1
CENTER KEYWAY
REFER TO VARIATIONS
(xB)

DETAIL A 11



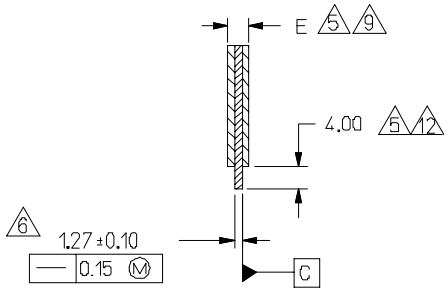
SCALE 4:1
LEFT OFFSET KEYWAY
REFER TO VARIATIONS
(xA)



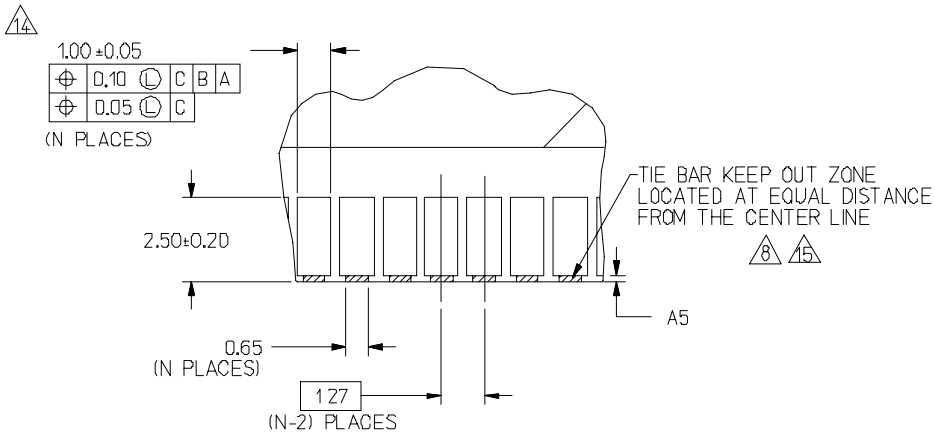
SCALE 4:1
RIGHT OFFSET KEYWAY
REFER TO VARIATIONS
(xC)

	Dual in line memory module (DIMM) family 184 pin DDR 1,27 mm contact centres	Date: 2002
	60191 IECI-165E-b	

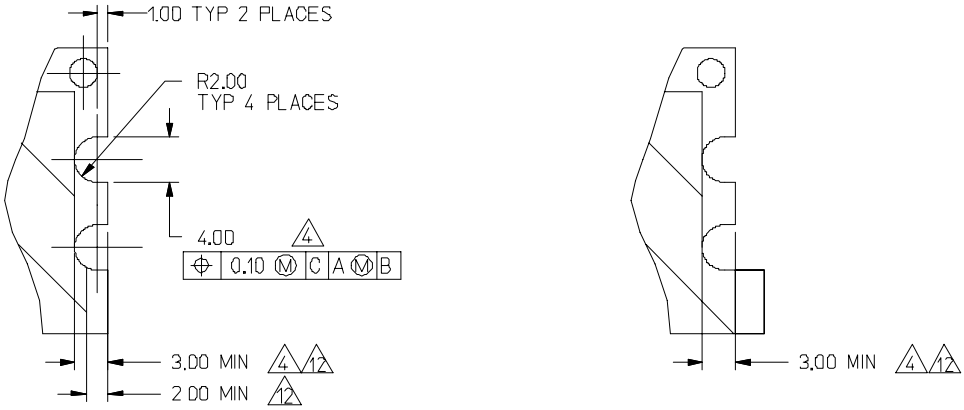
LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.



SECTION A-A



DETAIL C
SCALE 6:1



WHEN OPTIONAL EARS DO NOT EXIST

DETAIL B
SCALE 2:1

WHEN OPTIONAL EARS EXIST

	Dual in line memory module (DIMM) family 184 pin DDR 1,27 mm contact centres	Date: 2002
	60191 IECI-165E-c	

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

184 PIN DDR DIMM VARIATIONS
COMMON DIMENSION TABLE

SYMBOL	MIN	NOM	MAX	NOTES
A1		2.30		
A2		10.00		
A3		17.80		
A4		19.80		
A5	0.05	0.20	0.35	
D	138.30	138.45	138.60	13
D1	133.20	133.35	133.50	
D2		128.95		
E	–	–	9.00	5, 9
e1		64.77		
e2		49.53		
N		184		7
ISSUE		A		
REF		14-037		
NOTES		1, 3		

	AA 10			AB 10			AC 10			
SYMBOL	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	NOTES
A	25.25	25.40	25.55	25.25	25.40	25.55	25.25	25.40	25.55	
D3		2.175			3.175			4.175		11
D4		6.62			7.62			8.62		
ISSUE		A			A			A		
REF		14-037			14-037			14-037		
NOTES		1, 3			1, 3			1, 3		

	BA 10			BB 10			BC 10			
SYMBOL	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	NOTES
A	31.60	31.75	31.90	31.60	31.75	31.90	31.60	31.75	31.90	
D3		2.175			3.175			4.175		11
D4		6.62			7.62			8.62		
ISSUE		A			A			A		
REF										
NOTES		1, 3			1, 3			1, 3		

	CA 10			CB 10			CC 10			
SYMBOL	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	NOTES
A	43.05	43.18	43.31	43.05	43.18	43.31	43.05	43.18	43.31	
D3		2.175			3.175			4.175		11
D4		6.62			7.62			8.62		
ISSUE		B			B			B		
REF										
NOTES		1, 3			1, 3			1, 3		

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

1. ALL DIMENSIONING AND TOLERANCING CONFORM TO ASME Y14.5M-1994.

2. TOLERANCES ON ALL DIMENSIONS ± 0.13 mm UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

3. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

4. 3.00 mm MINIMUM APPLIES TO BOTH 4.00 mm WIDE NOTCH LENGTH AND THE BORDER OF THE COMPONENT KEEPOUT AREA.

5. DIMENSIONS ARE APPLICABLE WHEN COMPONENTS ARE MOUNTED ON EITHER SIDE OR BOTH SIDES OF MODULE.

6. THE CARD THICKNESS APPLIES ACROSS THE CONTACTS AND INCLUDES THE PLATING AND / OR THE METALLIZATION. THE STRAIGHTNESS CALLOUT APPLIES TO ZONE DEFINED BY THE 4.00 mm CONTACT AREA DIMENSION FOR THE ENTIRE LENGTH OF 133.35 mm.

7. N IS THE TOTAL NUMBER OF CIRCUIT CONTACTS (PI NS, LEADS, TABS, OR PADS).

8. THE LEADING EDGE OF THE CONTACT PADS SPECIFIED BY THE KEEPOUT ZONE SHALL BE FREE OF BURRS AND EXTERNAL TIE BARS.

9. WHEN SOJ DEVICES ARE USED FOR ASSEMBLY OF THIS MODULE, THE MAXIMUM OVERALL THICKNESS SHALL NOT EXCEED 9.00 mm. WHEN TSOP DEVICES ARE USED, THE MAXIMUM THICKNESS SHALL NOT EXCEED 3.67 mm.

10. VARIATIONS IN “A” (HEIGHT) ARE ASSIGNED AS FOLLOWS: AX = 25.40 mm, BX = 31.75 mm, AND CX = 43.18 mm.

11. VARIATIONS IN MODULE VOLTAGE ARE ASSIGNED AS FOLLOWS: XA = 2.5 VOLTS, XB = 1.8 VOLTS.

12. BORDER OF COMPONENT KEEPOUT AREA.

	Dual in line memory module (DIMM) family 184 pin DDR 1,27 mm contact centres	Date: 2002

60191 IECI-165E-e

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

13. WHEN OPTIONAL EARS ARE PRESENT, “D” IS THE CONTROLLING DIMENSION. WHEN THE OPTIONAL EARS ARE NOT PRESENT, “D” DOES NOT APPLY.

APPLICATION NOTES:

14. OPTION 1 – PREFERABLE PLATING, ELECTROLYTIC GOLD PLATING 0.76 MICROMETERS MINIMUM OVER ELECTROLYTIC Ni 2.0 MICROMETERS MIN.

OPTION 2 – ALTERNATE PLATING. GOLD PLATING 0.05 – 0.75 MICROMETERS OVER Ni 2.0 MICROMETERS MINUMUM MUST USE AN ELECTRONIC CONTACT GRADE CORROSIVE BARRIER LUBRICANT.

15. FOR OPTIMUM PERFORMANCE THE TIE BAR IS TO BE ON AN INTERNAL LAYER SO THAT THE REMNANT CANNOT CAUSE CONTACT DAMAGE.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

ISBN 2-8318-6223-X

9 782831 862231

ICS 31.080.01

Typeset and printed by the IEC Central Office
GENEVA, SWITZERLAND